

FEP Lay-Flat™

FEP 熱収縮押出成形製品

概要

FEP Lay-Flat™ 熱収縮品は、複合構造用のユニークな形状のレイアップや硬化に FEP 薄膜またはシームテープを使用する処理の代替品として選ばれる製品です。FEP Lay-Flat™ 熱収縮品は、スリーブとしてマンドレルに簡単に滑り込ませることができ、複合材料の製造を補助します。ネイティブ（ヴァージン）の FEP は、航空宇宙、自動車、風力エネルギーなどの多くの産業で複合材製造用樹脂として承認されており、好んで使用されます。

FEP Lay-Flat™ 熱収縮材は、複合材製造で優れた仕上がりとなり、超薄型の肉厚でお届けしています。手袋のようなフィット感を与えるこの製品は、フィルムよりも薄い肉厚が必要な用途のためのカスタマイズされた優れた選択肢です。

FEP Lay-Flat™ は、その絶縁特性に加え、バッテリーパック、バスバー、コンデンサ、壊れやすい電球などの鈍角で構成されたさまざまな形状を覆うために使用でき、熱、化学薬品からの保護や飛散防止となります。FEP Lay-Flat™ は紫外線（UV）光に対して透過性と耐性がありますので、殺菌および滅菌用途の UV 電球被覆に良く使用されます。



摩擦係数



耐薬品性



耐電圧



FEP Lay-Flat® はさまざまな色、長さ、サイズでご用意しており、使いやすいスプールに保管できます。

用途

- バッテリーパックの被覆
- バスバーの絶縁
- コンデンサの被覆
- 蛍光灯の被覆
- コンポジットリリース補助
- 電球飛散防止
- 紫外線殺菌および滅菌

製造能力および寸法

- 最長 500 ft (152 m) の長さをスプール巻取り可能
- シームレスなロング対応
- 外径 ¼" (6.35 mm) ~ ¾" (89 mm)
- 肉厚 0.002" (0.051 mm) ~ 0.010" (0.254 mm)
- 最高 1.6:1 の膨張率 (用途別にカスタマイズ)
- T5、T8、T12 電球サイズ

主要特性

- 紫外線耐性
- 耐薬品性
- 溶剤の低吸収性
- 滅菌可能
- 最高使用温度 400 °F / 204 °C

